

PowerEdge XE9680

Speziell entwickelt

- Der führende Anbieter von KI-Infrastrukturen laut Forrester® AI Infrastructure Wave
- 7:1 Konsolidierungsfähig*
- Bis zu 73 % mehr Energieeffizienz*

Intelligent

- Einsparungen von bis zu 50.000 US-Dollar durch Energie- und Managementoptimierung*¹
- 80 % der PowerEdge-Server erreichen das EPEAT Climate+-Siegel*¹
- Bis zu 150 Minuten weniger Zeit für das Management pro 100 Servern*¹
- Branchenführendes intelligentes Management
 - iDRAC 10 Integrated Controller und
 - OpenManage Enterprise

Ausfallsicher bei Cyberangriffen

- **3,5-mal** mehr Sicherheitsfunktionen als Mitbewerber*¹
- Unterstützt **Zero Trust**-Einführung
- Werkseitige Sicherheit mit Secured Component Verification

Nachhaltig

- **Auf Effizienz ausgelegt** Die Energieintensität (EI) von PowerEdge-Servern wurde in den letzten 8 Jahren um 83 % reduziert
- **Effizient** Bis zu 73 % mehr Energieeffizienz

PowerEdge XE Serie

Erschließen Sie das Potenzial von KI und High-Performance Computing mit dem Dell PowerEdge XE-Portfolio.

Ein umfassendes Lineup an Servern, die die strengen Anforderungen moderner KI-Workloads erfüllen.

Performance auf neuem Level

Die PowerEdge XE-Server wurden für alle entwickelt, die eine unübertroffene Ausfallsicherheit und unterbrechungsfreie Rechenleistung benötigen. Sie wurden mit hochmoderner Hardware entwickelt und sind für intensive Workloads optimiert. Diese Server verfügen über erweiterte Prozessor- und GPU-Architekturen, umfangreiche Arbeitsspeicherkonfigurationen und I/O-Funktionen mit hoher Bandbreite, um eine außergewöhnliche Performance in rechenintensiven Szenarien zu gewährleisten.



PowerEdge XE9680L/XE9685L

- Maßgeschneidert für KI-Modelltraining
- High-Performance Computing (HPC)
- Verfügbar als eigenständige Einheiten oder als Teil des neuesten Programms für skalierbare integrierte Racks

Cybersichere Architektur für Zero-Trust-IT-Umgebung und -Betrieb

Sicherheit ist in jede Phase des PowerEdge-Lebenszyklus integriert, einschließlich geschützter Lieferkette und Integritätsabsicherung von Werk zu Standort. Silicon-basierte Root of Trust Anchors, End-to-End-Startstabilität, während Multifaktor-Authentifizierung (MFA) und rollenbasierte Zugriffskontrollen vertrauenswürdige Vorgänge gewährleisten.

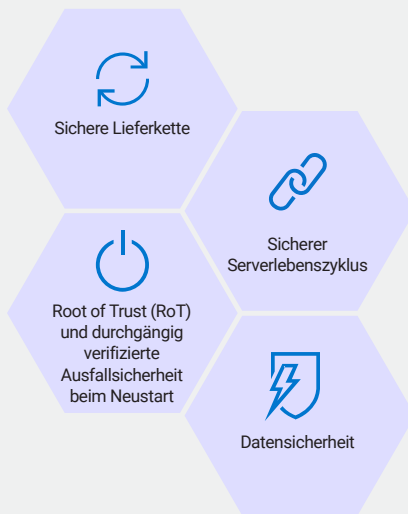
[Mehr erfahren](#)

Produktivitätssteigerung mit Dell System Management Solutions

Vereinfachen Sie das Infrastrukturmanagement mit iDRAC für eine sichere Remote-Serververwaltung, OpenManage Enterprise zur Optimierung des Lebenszyklusmanagements und KI-fähige AIOps zur Optimierung von Infrastruktur und Anwendungen. Automatisieren Sie Aufgaben, erhalten Sie Echtzeitwarnmeldungen und skalieren Sie mühelos, um Produktivität, Performance und Verfügbarkeit zu steigern.

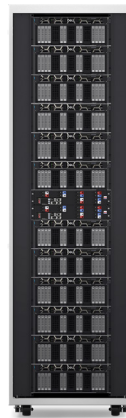
Sicherheit

Integration in jede Phase des Lebenszyklus



Maximale Leistung ohne thermische Einschränkungen

Stellen Sie sich den wachsenden Herausforderungen im Rechenzentrum, die durch künstliche Intelligenz und dichte Rechenlasten verursacht werden, mit einer Reihe von Lösungen, die Kühlstrategien für Rechenzentren verbessern, die Systemleistung optimieren und es Unternehmen ermöglichen, ein Gleichgewicht zwischen Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit herzustellen. [Mehr erfahren](#)



IR5000

XE-Server, skalierbare Architektur für zukünftiges Wachstum.

- Die integrierten Rack-Systeme von Dell Technologies wurden speziell entwickelt, um skalierbare Architekturen für Unternehmen zu unterstützen, die zukünftiges Wachstum erwarten.
- Die Rack-Scale-Integration von Dell optimiert die Bereitstellung mit vorab validierten Konfigurationen, um die Komplexität der Einrichtung und Integration zu reduzieren. [Mehr erfahren](#)

Fachkundige Unterstützung durch Dell Technologies Services

ProSupport Plus for Infrastructure.

- Maximieren Sie die Serververfügbarkeit mit proaktivem und vorausschauendem Support und 24/7 Zugang zu erfahrenen IngenieurInnen und TechnikerInnen
- Profitieren Sie von einem zugewiesenen Kundenvertreter, der sich auf Ihre gewünschten Ergebnisse konzentriert
- Profitieren Sie von der Zusammenarbeit mit Drittanbietern und einer missionkritischen Reaktion auf Schweregrad-1-Probleme

Optimieren Sie Ihre Server weiter mit Expertenberatung, Bereitstellung, Managed Services und mehr von Dell Technologies Services. Weitere Informationen zu [ProSupport Plus for Infrastructure](#) und [Services](#).

[Erfahren Sie mehr](#) darüber, wie PowerEdge XE-Server beispiellose Leistung, Skalierbarkeit und nahtlose Integration in neue oder bestehende Infrastrukturen bieten können, was sie zur idealen Lösung für komplexe, datenintensive Umgebungen macht, sei es als eigenständige Lösung oder in einer integrierten skalierbaren Rack-Lösung.



Dell Produkte, die besser zusammenarbeiten



Dell PowerSwitch Z9864F-ON – Ethernet-Fabric-Switch mit hoher Dichte für KI-/ML-Trainings- und Inferenzierungscluster.



Dell PowerVault – PowerVault bietet SAN/DAS-Lösungen, die die Kapazitätserweiterung für PowerEdge-Server vereinfachen



Funktion	XE9712	XE8712
Systeme		
Prozessoren	Zwei NVIDIA Grace mit 72 Cores pro Prozessor	Zwei NVIDIA Grace mit 72 Cores pro Prozessor
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> 480 GB LP-DDR5-Arbeitsspeicher mit ECC/CPU 288 GB HBM3e / GPU 	<ul style="list-style-type: none"> 480 GB LP-DDR5-Arbeitsspeicher mit ECC/CPU 192 GB HBM3e / GPU
GPUs	<ul style="list-style-type: none"> 4 Blackwell Ultra-GPU 900 GB/s kohärenter Arbeitsspeicher über NVLINK CPU-GPU-Interconnect 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Blackwell Ultra-GPU 900 GB/s kohärenter Arbeitsspeicher über NVLINK CPU-GPU-Interconnect
Integrierte Racklösung	IR9048	IR7044 oder IR7050
Rack- und Schlittenformfaktor	<ul style="list-style-type: none"> IR9048 ist ein 48-HE-Rack (Rack-Einheiten) Jeder XE9712-Schlitten hat 1 HE Hinweis: 1 RU = 44,45 mm (1,75 Zoll) hoch und 482,6 mm (19 Zoll) breit.	<ul style="list-style-type: none"> IR7044 ist ein Rack mit 44 OU (Open Rack Units) IR7050 ist ein Rack mit 50 HE (Höheneinheiten). Jeder XE8712-Schlitten hat 1 OU Hinweis: 1 OU = 48 mm (1,88 Zoll) hoch und 538,98 mm (21,22 Zoll) breit.
Storage-Controller	Direkte NVMe mit CX8-mezz-PCIe	Kein HBA oder PERC, nur direkte NVMe, OS RAID
Laufwerke (max. Kapazität), Hot-Swap	Bis zu 8 x EDSFF E3.S-Laufwerke (61,44 TB)	Bis zu 2 x EDSFF E3.S-Laufwerke (15,36 TB)
Netzteil-Redundanz, Hot-Swap-Fähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> 6 x 5500-W-Wechselstromnetzteile, die im Netzschacht installiert sind (33 kW) Die Stromversorgung des Netzteils beträgt 54 V Gleichstrom 	<ul style="list-style-type: none"> 6 x 5500-W-Wechselstromnetzteile, die im Netzschacht installiert sind (33 kW) Die Stromversorgung des Netzteils beträgt 54 V Gleichstrom
Kühlungsoptionen	<ul style="list-style-type: none"> Luftkühlung Direct Liquid Cooling (DLC) 	<ul style="list-style-type: none"> Direct Liquid Cooling (DLC)
PCIe-Steckplätze	<ul style="list-style-type: none"> Bis zu 2 x 16 Gen5-Steckplätze, volle Höhe und halbe Länge, nur Front-Riser 2 x Mezzanin – 5. Gen./6. Gen. 	<ul style="list-style-type: none"> Bis zu 4 x 16 Gen5-Steckplätze, volle Höhe und halbe Länge, nur Front-Riser
PCIe-Karten	<ul style="list-style-type: none"> 1 BF3 SuperNIC, volle Höhe, halbe Länge 	<ul style="list-style-type: none"> 1 BF3 SuperNIC, volle Höhe, halbe Länge
Startlaufwerke	<ul style="list-style-type: none"> 1 x M.2 Boot 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x M.2 Boot
Netzwerkoptionen	<ul style="list-style-type: none"> 1G integrated LOM 4 x 16 CX8 OSFP-Anschlüsse 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x OCP 3.0 4 x und 4 x 16 FHHL Gen 5 PCIe
Verkabelte Lüfter	8 G Effektivbeschleunigung (STD)	8 G Effektivbeschleunigung (HPR)
Höhe	43,6 mm (1,72 inches)	46,45 mm (1,83 inches)
Breite	438 mm (17,24 inches)	560 mm (22,05 inches)
Tiefe	807 mm (31,77 inches)	840,85 mm (33,10 inches)
Blende	-	-
Maximales Gewicht	30 kg (66,14 Pfund)	33,07 kg (72,90 Pfund)
Integriertes Management	<ul style="list-style-type: none"> Aspeed AST2600 BMC DC-SCI-kompatibel OpenBMC BMC-to-NVIDIA HMC für HPM-Management 	<ul style="list-style-type: none"> iDRAC10
Frontschnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.0 Typ-A-Anschluss 1 RJ45 (BF3-Managementanschluss – optional) 1 Mini-DisplayPort 1 x BIOS serieller Ausgang 4 x OSFP 1 x 1 GbE LOM 1 x RJ45; dedizierter BMC-Anschluss 	<ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.0 Typ-A-Anschluss 1 x RJ45; dedizierter BMC-Anschluss 1 x DisplayPort 1 x OCP 3.0 Gen 5 1 x RJ45 (BF3-Managementanschluss)
Schienenunterstützung	Statische Schienen für ORv3 IR9048-Rack	Statische Schienen für ORv3 IR7000-Rack
Betriebssysteme	GraceOS	<ul style="list-style-type: none"> Canonical Ubuntu Server LTS Red Hat Enterprise Linux

Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport.

Funktion	XE9785L	XE9780L/XE9780LAP
Systeme		
Prozessoren	Zwei AMD EPYC 9005 Serie-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 192 Cores pro Prozessor	XE9780L: zwei Intel Xeon 6 Prozessoren mit bis zu 86 Cores pro Prozessor* XE9780LAP: zwei Intel Xeon 6 Prozessoren mit bis zu 128 Cores pro Prozessor*
DDR5-RDIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	24 (6 TB)*	XE9780L: 32 (4 TB) XE9780LAP: 24 (6 TB)*
GPUs	8 AMD Instinct™ MI355X 288 GB 1400 W OAM mit AMD Infinity Fabric Connectivity 8 NVIDIA HGX B300 NVL8 270 GB 1100W SXM6-GPUs, vollständig vernetzt mit NVIDIA NVLink-Technologie*	8 NVIDIA HGX B300 SXM6-GPUs mit 1100 W, die vollständig mit der NVIDIA NVLink-Technologie verbunden sind
Rack	IR7000 ist erforderlich	IR7000 ist erforderlich
Interner Start	Integrierte BOSS-N1: HWRAID 0/1, 2 x M.2-NVMe-SSDs	Integrierte BOSS-N1: HWRAID 0/1, 2 x M.2-NVMe-SSDs
Integrierter OSFP	B300: 8 x CX8 OSFP (Standard)	B300: 8 x CX8 OSFP (Standard)
Laufwerke (max. Kapazität)	16 x E1.S (122,88 TB) 8 x U.2 NVMe-SSDs (245,76 TB)	16 x E1.S (122,88 TB) 8 x U.2 NVMe- + 2 x U.2 NVMe-Laufwerke nach PCIe CEM (307,2 TB)*
Netzteil-Redundanz, Hot-Swap-Fähigkeit	6 x 5500-W-Wechselstromnetzteile, die im Netzschacht installiert sind (33 kW)	6 x 5500-W-Wechselstromnetzteile, die im Netzschacht installiert sind (33 kW)
Kühlungsoptionen	Flüssigkeitsgekühlte CPUs, GPUs und NVLink-Switches	Flüssigkeitsgekühlte CPUs, CX8, GPUs und NVLink-Switches
Rack-Höhe	3-HE-Compute-Node im IR7000 = 44 oder 50 HE (offene Rackeinheiten)	3-HE-Compute-Node im IR7000 = 44 oder 50 HE (offene Rackeinheiten)
PCIe-Steckplätze	Bis zu 12 x16 Gen5-Steckplätze, volle Höhe und halbe Länge	Bis zu 4 x16 Gen5-Steckplätze, volle Höhe und halbe Länge
Netzwerkoptionen	1 x OCP NIC-Karte 3.0 (x16 PCIe-Lanes)	1 x OCP NIC-Karte 3.0 (x16 PCIe-Lanes)
Hot-Swap-fähige Lüfter	4 STD auf UBB + 8 STD auf HPM	4 STD auf UBB + 8 STD auf HPM
Höhe	140,5 mm (5,53 inches)	140,5 mm (5,53 inches)
Breite	537 mm (21,14 inches)	537 mm (21,14 inches)
Tiefe	1047,95 mm (41,26 Zoll) für UBB 889,65 mm (35,03 Zoll) für HPM	1047,95 mm (41,26 Zoll) für UBB 889,65 mm (35,03 Zoll) für HPM
Blende	-	-
Maximales Gewicht	95 kg (209,43 Pfund)	107,2 kg (236,33 lbs)
Integriertes Management	iDRAC10, iDRAC Direct, iDRAC RESTful API mit Redfish, RACADM CLI, iDRAC Servicemodul	iDRAC10, iDRAC Direct, iDRAC RESTful API mit Redfish, RACADM CLI, iDRAC Servicemodul
Tools	IPMI	IPMI
OpenManage Integrations	Red Hat Ansible Modules, Terraform-Anbieter	Red Hat Ansible Modules, Terraform-Anbieter
Integrierte Sicherheit	Kryptografisch signierte Firmware, Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement)*, Secure Boot, Secured Component Verification (Hardwareintegritätsprüfung), Secure Erase, Silicon Root of Trust, Systemsperre, auf der HPM-Platine verlötetes TPM, Gehäuseeingriffserkennung, AMD Secure Memory Encryption (SME), AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV)	Kryptografisch signierte Firmware, Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), Secure Boot, Secured Component Verification (Hardwareintegritätsprüfung), Secure Erase, Silicon Root of Trust, Systemsperre, auf der Mezzanine DC-CSM-Platine verlötetes TPM, Gehäuseeingriffserkennung.
Frontschnittstellen	1 x USB 3.0 Typ-A-Anschluss, 1 x Mini-DisplayPort, 1 x USB 2.0 Typ-C-Anschluss, 2 x dedizierter RJ45-iDRAC-Ethernetanschluss Hinweis: Alle Anschlüsse befinden sich auf der FIO-Platine (Front I/O)	1 x USB 3.0 Typ-A-Anschluss, 1 x Mini-DisplayPort, 1 x USB 2.0 Typ-C-Anschluss, 2 x dedizierter RJ45-iDRAC-Ethernetanschluss Hinweis: Alle Anschlüsse befinden sich auf der FIO-Platine (Front I/O)
Interner Anschluss	1 USB 3.1 Type-A	1 USB 3.1 Type-A
Betriebssysteme	Canonical Ubuntu Server LTS, Red Hat Enterprise Linux	Canonical Ubuntu Server LTS, Red Hat Enterprise Linux*



Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport.

Hinweis: * Funktion bei Produkteinführung nicht verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter Dell.com.



Funktion	XE9785	XE9780
Systeme		
Prozessoren	Zwei AMD EPYC 9005 Serie-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 192 Cores pro Prozessor	Zwei skalierbare Intel Xeon Prozessoren der 6. Generation mit bis zu 86 Cores pro Prozessor
DDR5-RDIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	24 (6 TB)	32 (4 TB)
GPUs	8 AMD Instinct™ MI355X 288 GB 1400 W OAM mit AMD Infinity Fabric Connectivity 8 x NVIDIA HGX B300 270 GB SXM6-GPUs mit 1100 W, vollständig vernetzt mit NVIDIA NVLink-Technologie	8 NVIDIA HGX B300 NVL8 270 GB 1100W SXM6-GPUs, vollständig vernetzt mit NVIDIA NVLink-Technologie 8 x NVIDIA HGX B200 SXM6-GPUs mit 180 GB und 1000 W, die vollständig mit der NVIDIA NVLink-Technologie verbunden sind Ohne GPU-Konfiguration
Interner Start	Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS mit 2 x 2280 M.2 SSDs)	Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS mit 2 x 2280 M.2 SSDs)
Integrierter OSFP	B300: 8 x CX8 OSFP (Standard)	B300: 8 x CX8 OSFP (Standard)
Laufwerke (max. Kapazität)	16 x E3.S NVMe-Direct-Laufwerke (245,76 TB) 10 x U.2 NVMe-SSDs (153,6 TB)	16 x E3.S NVMe-Direct-Laufwerke (245,76 TB) 10 x U.2 NVMe-SSDs (153,6 TB)
Netzteil-Redundanz, Hot-Swap-Fähigkeit	12 x 3200 W Titanium, 200–240 VAC oder 240 VDC	12 x 3200 W Titanium, 200–240 VAC oder 240 VDC
Kühlungsoptionen	Luftkühlung	Luftkühlung
Rack-Höhe	10 HE	10 HE
PCIe-Steckplätze	MI355X: 12 x 75W Gen5 x16 FHHL-Karten B300: 4 x 150 W Gen5 x16-FHHL-Karten	B300: 4 x 150 W Gen5 x16-FHHL-Karten B200: bis zu 12 (8 x 75 W, 4 x bis zu 150 W) Gen5 x16-FHHL-Karten
Netzwerkoptionen	1 x OCP NIC-Karte 3.0 (x8 PCIe-Lanes)	1 x OCP NIC-Karte 3.0 (x8 PCIe-Lanes)
Lüfter	15 GPU-Lüfter der Standardklasse. Alle sind Hot-Swap-Lüfter + 5 CPU-Lüfter der Standardklasse. Alle sind Cold-Swap-Lüfter	15 GPU-Lüfter der Standardklasse. Alle sind Hot-Swap-Lüfter + 5 CPU-Lüfter der Standardklasse. Alle sind Cold-Swap-Lüfter
Höhe	439,5 mm (17,30")	439,5 mm (17,30")
Breite	482,3 mm (18,98 Zoll)	482,3 mm (18,98")
Tiefe	1044,7 mm (41,12 Zoll) mit Blende 1023 mm (40,27") ohne Blende	1044,7 mm (41,12 Zoll) mit Blende 1023 mm (40,27") ohne Blende
Blende	Vordere Sicherheitsblende	Vordere Sicherheitsblende
Maximales Gewicht	172,3 kg (379,86 Pfund)	163,20 kg (359,04 Pfund)
Integriertes Management	iDRAC10, iDRAC Direct, iDRAC RESTful API mit Redfish, iDRAC Service Module	iDRAC10, iDRAC Direct, iDRAC RESTful API mit Redfish, iDRAC Service Module
Tools	Dell System Update, Dell Repository Manager, Enterprise-Kataloge, iDRAC RESTful API mit Redfish, IPMI, RACADM CLI	Dell System Update, Dell Repository Manager, Enterprise-Kataloge, iDRAC RESTful API mit Redfish, IPMI, RACADM CLI
OpenManage Integrations	BMC Truesight, OpenManage Integration mit ServiceNow, RedHat Ansible Modules, Terraform-Anbieter	BMC Truesight, OpenManage Integration mit ServiceNow, RedHat Ansible Modules, Terraform-Anbieter
Integrierte Sicherheit	Kryptografisch signierte Firmware, Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement)*, Secure Boot, Secured Component Verification (Hardwareintegritätsprüfung), Secure Erase, Silicon Root of Trust, Systemsperre, auf Mezzanine DC-SCM verlötetes TPM, Gehäuseeingriffserkennung, AMD Secure Memory Encryption (SME), AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV)	Kryptografisch signierte Firmware, Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), Secure Boot, Secured Component Verification (Hardwareintegritätsprüfung), Secure Erase, Silicon Root of Trust, Systemsperre, auf der Mezzanine DC-SCM-Platine verlötetes TPM, Gehäuseeingriffserkennung
Frontschnittstellen	1 iDRAC Direct-Anschluss (USB C), 2 dedizierte RJ45-iDRAC-Ethernetanschlüsse, 1 USB A, 1 Mini-DisplayPort	1 iDRAC Direct-Anschluss (USB C), 2 dedizierte RJ45-iDRAC-Ethernetanschlüsse, 1 USB A, 1 Mini-DisplayPort
Anschlüsse auf der Rückseite	-	-
Betriebssysteme	Canonical Ubuntu Server LTS, Red Hat Enterprise Linux*	Canonical Ubuntu Server LTS, Red Hat Enterprise Linux

Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport.

Hinweis: * Funktion bei Produkteinführung nicht verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter Dell.com.




Funktion	XE9680L	XE9685L
Systeme		
Prozessoren	Zwei skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 64 Cores pro Prozessor	Zwei AMD EPYC™ 9005 Serie-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 192 Cores pro Prozessor
DDR5-RDIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	32 (4 TB)	24 (3 TB)
GPUs	8 x NVIDIA HGX B200 SXM6-GPUs mit 180 GB und 1.000 W, die vollständig mit der NVIDIA NVLink-Technologie verbunden sind	
Rack	IR5000 erforderlich	
Interner Start	BOSS-N1: HWRAID 1, 2 x M.2-NVMe-SSDs	
Laufwerke (max. Kapazität)	8 x 2,5"-NVMe/SAS/SATA-SSDs (122,88 TB)	
Netzteil-Redundanz, Hot-Swap-Fähigkeit	3000 W Titanium, 200–240 VAC oder 240 VDC	3000 W Titanium, 200–240 VAC oder 240 VDC 3000 W bei Verwendung bei 209,1–240 VAC oder 240 VDC* 2800 W bei Verwendung bei 200-209 VAC
Kühlungsoptionen	Flüssigkeitsgekühlte CPUs, GPUs und NVLink-Switches	
Rack-Höhe	4 HE	
PCIe-Steckplätze	Bis zu 12 x16 Gen5-Steckplätze, volle Höhe und halbe Länge	
Integrierter NIC	2 x 1 GbE	
Netzwerkoptionen	1 x OCP NIC-Karte 3.0 (x8 PCIe-Lanes)	
Hot-Swap-fähige Lüfter	6 HPR auf oberer Ebene + 6 HPR auf unterer Ebene	
Höhe	174,3 mm (6,86")	
Breite	Oben 2 HE: 447 mm (17,59 Zoll) Unten 2 HE: 434 mm (17,08")	
Tiefe	1037,57 mm (40,82") mit Blende 1025,62 mm (40,37 Zoll) ohne Blende	
Blende	Optionale LCD-Blende oder Sicherheitsblende	
Maximales Gewicht	95,60 kg (206,35 Pfund)	91,63 kg (202,00 Pfund)
Integriertes Management	iDRAC9, iDRAC Direct, iDRAC RESTful API with Redfish, iDRAC Service Module, Dell Connectivity Client	
OpenManage Software	CloudIQ for PowerEdge-Plug-in, OpenManage Enterprise (OME), OpenManage Service-Plug-in, OpenManage Power Manager-Plug-in, OpenManage Update Manager-Plug-in	OME Dell APEX AIOps Observability OpenManage Enterprise (OME), OpenManage Service-Plug-in, OpenManage Power Manager-Plug-in, OpenManage Update Manager-Plug-in
OpenManage Integrations	BMC TrueSight, OpenManage Integration in ServiceNow, Red Hat Ansible Modules, Terraform-Anbieter	OpenManage Integration in ServiceNow, Red Hat Ansible Modules, Terraform Providers
Integrierte Sicherheit	TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, kryptografisch signierte Firmware, Secure Boot als Standardsicherheit, Silicon Root of Trust, Systemsperre (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Rechenzentrum), Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) und Systemlöschung auf allen Racks.	
Frontschnittstellen	1 x iDRAC Direct-Port (Micro-AB USB), 1 x USB 2.0, 1 x VGA	
Anschlüsse auf der Rückseite	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x iDRAC Direct Ethernet-Anschluss	
Betriebssysteme	Canonical Ubuntu Server LTS, Red Hat Enterprise Linux	
OEM Ready-Version erhältlich	Von der Blende über das BIOS bis hin zur Verpackung: Ihre Server können aussehen wie von Ihnen entworfene und gefertigte Produkte, dank unserer OEMR-Plattformen. Die XL-Plattformen bieten erweiterte Übergänge und Stabilität für NutzerInnen von OEM Solutions. Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com > Solutions > OEM Solutions.	

Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter [Dell.com/OSsupport](https://www.dell.com/OSsupport).

Funktion	XE7745	XE7740
Systeme		
Prozessoren	Zwei AMD EPYC™ 9005 Serie-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 192 Cores pro Prozessor	Zwei Intel® Xeon® 6 Prozessoren mit bis zu 144 Cores pro Prozessor
DDR5-RDIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	24 (3 TB)	32 (4 TB)
GPUs	8 x PCIe Gen 5 x16 DW-FHFL mit bis zu 600 W oder 16 x PCIe Gen 5 x16 SW-FHFL mit bis zu 75 W <ul style="list-style-type: none"> NVIDIA RTX Pro™ 6000 Blackwell Server Edition 600 W (DW, 96 GB) NVIDIA H200 NVL 600 W (DW, 141 GB) NVIDIA H200 NVL 400 W (DW, 94 GB) NVIDIA L40S 350 W (DW, 48 GB) NVIDIA L4 72 W (SW, 24 GB) 	8 x PCIe Gen 5 x16 SW-FHFL mit bis zu 75 W <ul style="list-style-type: none"> NVIDIA RTX Pro™ 6000 Blackwell Server Edition 600 W (DW, 96 GB) NVIDIA H200 NVL 600 W (DW, 141 GB) NVIDIA H200 NVL 400 W (DW, 94 GB) NVIDIA L40S 350 W (DW, 48 GB) INTEL Gaudi3 600 W (DW, 128 GB) NVIDIA L4 72 W (SW, 24 GB)
Interner Start	BOSS-N1: HWRAID 1, 2 x M.2-NVMe-SSDs	
Laufwerke (max. Kapazität)	8 x 2,5"-NVMe/SAS/SATA-SSDs (122,88 TB)	
Netzteil-Redundanz, Hot-Swap-Fähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> 3.200 W Titanium, 200–240 VAC oder 240 VDC Multi-Kapazität für 3200 W PSU: 3200 W für 220.1-240 V Wechselstrom oder 2900 W für 200-220 V Wechselstrom <ul style="list-style-type: none"> 3200 W Titanium 277 V AC oder 336 V DC 2400 W Titanium, 200–240 VAC oder 240 VDC 	
Kühlungsoptionen	Luftkühlung	
Rack-Höhe	4 HE	
PCIe-Steckplätze	Bis zu 8 PCIe-Gen5-x16-SW-FHHL-Karten mit jeweils bis zu 150 W	
Integrierter NIC	-	
Netzwerkoptionen	1 x OCP NIC-Karte 3.0 (x8 PCIe-Lanes)	
Hot-Swap-fähige Lüfter	4 Sätze HPR im mittleren Fach + 12 HPR auf der Vorderseite	
Höhe	174,3 mm (6,86")	
Breite	482 mm (18,98 Zoll)	
Tiefe	899,56 mm (35,42") mit Blende 886,73 mm (34,91") ohne Blende	
Blende	Optionale Sicherheitsblende	
Maximales Gewicht	68,5 kg (151,02 lb)	71,35 kg (157,30 Pfund)
Integriertes Management	iDRAC10, iDRAC Direct, iDRAC RESTful API mit Redfish, iDRAC Service Module, RACADM CLI	
OpenManage-Konsole	OpenManage Enterprise (OME), OME Power Manager, OME Services, OME Update Manager, OME APEX AIOps Observability, OME Integration for VMware vCenter (mit VMware Aria Operations)	
Tools	IPMI	
Änderungsmanagement	Enterprise-Kataloge/Linux-Repositorys	
OpenManage Integrations	Red Hat Ansible Modules, Terraform-Anbieter	
Integrierte Sicherheit	TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, kryptografisch signierte Firmware, Gehäuseeingriffserkennung, Secure Boot als Standardsicherheit, Silicon Root of Trust, System Sperre (erfordert iDRAC10 Enterprise oder Rechenzentrum), Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) und Systemlöschung auf allen Racks.	
Frontschnittstellen	1 x USB 2.0 Typ A (optional), 1 x Mini-Displayanschluss (optional), 1 x USB 2.0 Typ C Dual-Modus (Host/iDRAC Direct-Anschluss)	
Anschlüsse auf der Rückseite	1 x dedizierter iDRAC/BMC Direct-Ethernetanschluss, 2 x USB 3.1 Typ-A-Anschluss, 1 x VGA	
Interne Anschlüsse	1 USB 3.1 Type-A	
Betriebssysteme und Hypervisoren	Canonical Ubuntu Server LTS, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi	
OEM Ready-Version erhältlich	Von der Blende über das BIOS bis hin zur Verpackung – Ihre Server können aussehen wie von Ihnen entworfene und gefertigte Produkte. Weitere Informationen erhalten Sie unter Dell.com/OEM .	

Technische Daten und Details zur Interoperabilität finden Sie unter Dell.com/OSsupport.

Hinweis: * Funktion bei Produkteinführung nicht verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit der Funktionen finden Sie auf der Produktkonfiguratorseite unter Dell.com.

Funktion	XE9680	XE9640	XE8640
Systeme			
Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren mit Intel® C741 Chipsatz:	Zwei skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 64 Cores pro Prozessor		
DDR5-RDIMM-Steckplätze (max. Kapazität)	Zwei skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 4. Generation mit bis zu 56 Cores pro Prozessor		
GPUs	<p>8 NVIDIA HGX H100 SXM5-GPUs mit 80 GB und 700 W, die vollständig mit der NVIDIA NVLink-Technologie verbunden sind, oder 8 NVIDIA HGX H200 141 GB SXM5-GPUs mit 700 W, vollständig vernetzt mit NVIDIA NVLink-Technologie oder 8 NVIDIA HGX H20 SXM5-GPUs mit 96 GB und 500 W, die vollständig mit der NVIDIA NVLink-Technologie verbunden sind, oder 8 AMD Instinct MI300X 192 GB 750 W OAM-Accelerator mit AMD Infinity Fabric Connectivity oder 8 Intel Gaudi 3 128 GB 900 W OAM Accelerator mit integrierten RoCE-Anschlüssen für Ethernetkonnektivität</p> <p>Verbessern Sie die generative KI-Trainingsleistung durch GPU-GPU-Kommunikation und bis zu 1,5 TB gemeinsam genutzten kohärenten GPU-Speicher, der Teil dieser Angebote ist.</p>	4 NVIDIA H100 oder Intel Data Center Max GPU Serie 1550	4 x NVIDIA H100
Interner Controller	PERC H965i (nicht unterstützt mit Intel Gaudi3)	-	-
Interner Start Software-RAID	BOSS-N1: HWRAID 1, 2 x M.2-NVMe-SSDs S160		
Laufwerke (max. Kapazität)	8 x 2,5"-NVMe/SAS/SATA-SSDs (122,88 TB), 16 x E3.S-NVMe-Direct-Laufwerke (122,88 TB) Hinweis: Nur 8 x 2,5"-NVMe-SSD-Laufwerke werden mit Intel Gaudi3 unterstützt.	4 x 2,5"-NVMe-SSDs (61,44 TB)	8 x 2,5"-NVMe/SAS/SATA-SSDs (122,88 TB), 16 x E3.S-NVMe-SSDs (122,88 TB)
Netzteil-Redundanz, Hot-Swap-Fähigkeit	3200 W Titanium, 277 V Wechselstrom oder 260-400 V Gleichstrom (nur in den USA und Kanada verfügbar) 3000 W Titanium, 200-240 V Wechselstrom oder 240 V Gleichstrom (nur mit Intel Gaudi 3) Multi-Kapazität für 3000 W PSU: 3000 W für 209.1-240 V Wechselstrom oder 2800 W für 200-209 V Wechselstrom 2.800 W Titanium 200-240 V Wechselstrom/240 V Gleichstrom	2.800 W Titanium 200-240 V Wechselstrom/240 V Gleichstrom	3200 W Titanium 277 V Wechselstrom oder 260-400 V Gleichstrom 2.800 W Titanium 200-240 V Wechselstrom/240 V Gleichstrom
Kühlungsoptionen	Luftkühlung	Flüssigkeitskühlung mit internem Verteiler	Luftkühlung für CPUs + flüssigkeitsunterstützte Luftkühlung für GPU
Rack-Höhe	6 HE	2 HE	4 HE
PCIe-Steckplätze	Es stehen bis zu 10 nach vorne gerichtete PCIe Gen 5-Steckplätze zur Verfügung, wobei 8 Steckplätze für Intel Gaudi3 verfügbar sind	4 x16 Gen5	
Integrierter NIC	2 x 1 GbE		
Integrierter OSFP	6 x 800 GB (nur mit Intel Gaudi 3 verfügbar)	-	-
Netzwerkoptionen	1 x OCP 3.0 (x8 PCIe-Lanes)		
Hot-Swap-fähige Lüfter	10 HPR im mittleren Fach + 10 HPR auf der Rückseite (bis zu 12 Lüfter mit Intel Gaudi 3)	4 Sätze (Modul mit zwei Lüftern) HPR	6 STD im mittleren Fach + 5 HPR auf der Vorderseite
Höhe	263,2 mm (10,36")	86,8 mm (3,41 Zoll)	174,3 mm (6,86 inches)
Breite	482,0 mm (18,97 Zoll)	482 mm (18,97 Zoll)	481,91 mm (18,97 Zoll)

Funktion	XE9680	XE9640	XE8640
Tiefe	1008,77 mm (39,71") mit Blende 995 mm (39,17") ohne Blende	926,5 mm (36,47 Zoll) mit Blende 912,8 mm (35,93") ohne Blende	901,4 mm (35,48 Zoll) mit Blende 865,54 mm (34,07 Zoll) ohne Blende
Blende	Optionale LCD-Blende oder Sicherheitsblende		
Maximales Gewicht	114,05 kg (251,44 Pfund)	46,3 kg (102,07 lb)	61,4 kg (135,36 lb)
Integriertes Management	iDRAC9, iDRAC Direct, iDRAC RESTful API mit Redfish, iDRAC Service Module		
OpenManage Software	CloudIQ for PowerEdge-Plug-in, OpenManage Enterprise, OpenManage Service-Plug-in, OpenManage Power Manager-Plug-in, OpenManage Update Manager-Plug-in		
OpenManage Integrations	BMC TrueSight, OpenManage Integration in ServiceNow, Red Hat Ansible Modules, Terraform-Anbieter		
Integrierte Sicherheit	TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ, kryptografisch signierte Firmware, Alarm bei Gehäuseeinbruch, Secure Boot als Standardsicherheit, Silicon Root of Trust, Systemsperrung (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Rechenzentrum), Data-at-Rest-Verschlüsselung (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement), gesicherte Komponentenverifizierung (Hardwareintegritätsprüfung) und Systemlöschung auf allen Racks.		
Frontschnittstellen	1 x iDRAC Direct-Port (Micro-AB USB), 1 x USB 2.0, 1 x VGA		
Anschlüsse auf der Rückseite	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA 1 x RJ45 iDRAC9-Ethernet-Anschluss	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RJ-45 iDRAC9-Ethernet-Anschluss	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x RJ45 iDRAC9-Ethernet-Anschluss
Betriebssysteme und Hypervisoren	Canonical Ubuntu Server LTS Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi	Canonical Ubuntu Server LTS Red Hat Enterprise Linux	
OEM Ready-Version erhältlich	Von der Blende über das BIOS bis hin zur Verpackung: Ihre Server können aussehen wie von Ihnen entworfene und gefertigte Produkte, dank unserer OEMR-Plattformen. Die XL-Plattformen bieten erweiterte Übergänge und Stabilität für NutzerInnen von OEM Solutions. Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com > Solutions > OEM Solutions.		

Informationen zum Kauf von Dell PowerEdge-Servern finden Sie unter [Dell.com](https://www.dell.com).

Weitere Informationen zu plattformsspezifischen Spezifikationen und weiteren Details finden Sie im technischen Handbuch auf [Dell.com](https://www.dell.com).

Nachhaltig

Von recycelten Materialien in unseren Produkten und Verpackungen bis hin zu durchdachten, innovativen Optionen für Energieeffizienz – das PowerEdge-Portfolio wurde entwickelt, um Produkte herzustellen, bereitzustellen und zu recyceln, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Ihre Betriebskosten zu senken. Mit Dell Technologies Services erleichtern wir sogar die verantwortungsbewusste Stilllegung von veralteten Systemen.



Weitere Informationen
zu Dell Networking-
Lösungen



Kontakt zum Dell
Technologies
Expertenteam



Weitere
Ressourcen
anzeigen



Folgen Sie uns auf [Dell.com](https://www.dell.com)



Folgen Sie uns auf X



Folgen Sie uns auf LinkedIn

Reden Sie mit:
#DellTechnologies